

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2018-023

上海韦尔半导体股份有限公司
关于 2018 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署
银行借款相关合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司于 2018 年 4 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2018 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》，公司及子公司预计 2018 年度向银行申请综合授信总额不超过人民币 10 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务，最大限度的保证公司资金使用效益。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日